SPOT
ISSUE

15 Apr. 2026

DAOL 다올투자증권

(Overweight)

전기전자

4월 기판 동향 업데이트 (ASIC / 판가 / 투자)

김연미
전기전자 I ym.kim@daolfn.com

● **① ASIC 사업자 동향: 외부 판매 가속화**

기존까지 ASIC 생산량은 빅테크 각각의 자체 인프라 CapEx 규모에 연동되는 구조였으나, 최근 외부 고객 대상 직접 판매 모델로의 전환 본격화. 이는 ASIC 수요의 결정 변수가 내부 투자에서 실제 고객 수요로 이동하는 변화로 해석 가능

[Google] Google은 Anthropic과 TPU 공급 계약을 체결하며 외부 판매 확대 규모를 구체화하고 있으며, 공급 구조는 Broadcom을 통한 직접 판매와 GCP 기반 렌탈을 병행하는 형태로 추정. Anthropic향 TPU 공급 규모는 26년 약 1GW 수준에서 27년 3.5GW까지 확대될 것으로 언급되며, 단일 고객 기준으로 의미 있는 출하규모 확인. Anthropic 외에도 Meta, xAI, OpenAI 등이 TPU 도입을 검토 또는 진행 중
[Amazon] 4월 9일 주주서한을 통해 Trainium 칩을 외부에 직접 판매하는 방안을 검토 중이라고 공식화. 현재 자체 칩 사업(Trainium+Graviton+Nitro)의 연간 매출 run rate는 $200억 이상이며, 외부 판매로 전환 시 $500억 수준으로 확대 가능하다고 언급. 수요 측면에서는 Trainium2 완판, Trainium3도 출하 시작 직후 대부분 예약 완료, Trainium4는 출시 18개월 전임에도 상당 물량이 이미 선예약된 상태

● **② 기판 밸류체인 전반의 가격 상승 압력 확대**

AI 서버 및 ASIC 수요 확대에 따라 기판에 적용되는 고사양 소재 중심으로 타이트한 수급이 이어지는 모습. 특히 고급 유리섬유(T-Glass), M8/M9급 고사양 CCL, ABF 필름 등 주요 원재료에서 공급 부족과 가격 상승이 동반. 이에 따라 기판 업체들의 판가 인상 움직임도 본격화되는 흐름. 최근 FC-BGA 판가는 원가 상승분을 상회하는 수준이며, 약 10% 이상 상향 조정된 것으로 파악

● **③ 삼성전기 FC-BGA 대규모 투자 가시화**

삼성전기가 베트남 생산법인에 약 12억달러(약 1.8조원) 규모를 투자한다는 계획 보도. 28년 이후 물량 대응을 위한 것으로 파악. 22년 이후 약 4년만에 재개된 대규모 FC-BGA 투자인 점이 고무적. 기존 및 신규 거래선 전반의 중장기 수요 가시성이 확대된 것으로 추정

● **투자전략**

고사양 기판 중심의 수요 강세가 지속되는 가운데, 단기적으로 공급 확대가 제한적인 상황. 이에 따라 타이트한 수급이 유지되며 판가 및 수익성 개선 흐름이 이어질 전망. 특히 소재·장비를 포함한 밸류체인 전반으로 실적 개선이 확산될 것으로 판단하며, 전기전자 및 기판 업종에 대한 Overweight 의견 유지

Fig. 1: Broadcom 4/6 Google, Anthropic 관련 공시 원문

Broadcom과 Google은 Google의 차세대 TPU를 위한 맞춤형 TPU 개발 및 공급을 위한 장기 계약을 체결.
또한 Broadcom은 2031년까지 Google의 차세대 AI 랙을 지원하기 위한 네트워크 및 기타 구성요소를 공급하는 보장 계약도 체결

Item 8.01 Other Events.

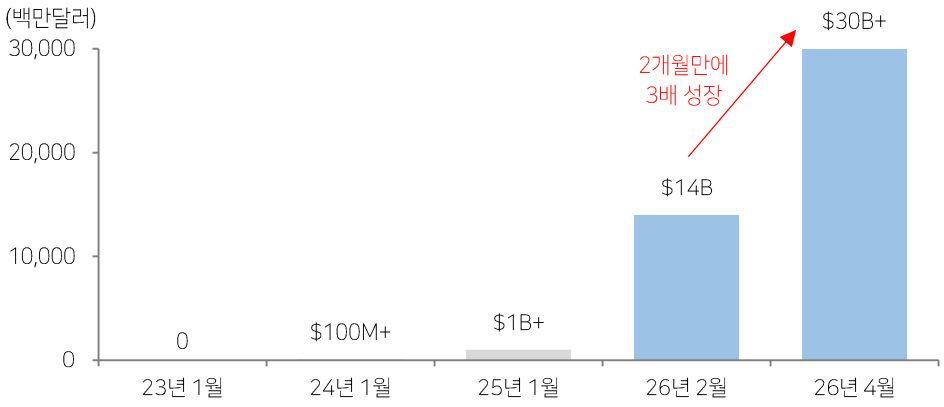
Broadcom Inc. ("Broadcom") and Google LLC ("Google") have entered into a Long Term Agreement for Broadcom to develop and supply custom Tensor Processing Units ("TPUs") for Google's future generations of TPUs and a Supply Assurance Agreement for Broadcom to supply networking and other components to be used in Google's next-generation AI racks through up to 2031.

Separately, Broadcom, Google and Anthropic PBC ("Anthropic") have expanded their current strategic collaboration under which Anthropic, beginning in 2027, will access through Broadcom approximately 3.5 gigawatts as part of the multiple gigawatts of next generation TPU-based AI compute capacity committed by Anthropic. The consumption of such expanded AI compute capacity by Anthropic is dependent on Anthropic's continued commercial success. In connection with this deployment, the parties are in discussions with certain operational and financial partners.

별도로 Google, Broadcom, Anthropic은 기존 전략적 협력을 확대하였으며,
이에 따라 Anthropic은 2027년부터 Broadcom을 통해 Anthropic이 약정한 약 3.5GW 규모의 TPU 기반 AI 연산 인프라에 접근 가능.
확대된 AI 연산 CAPA 사용은 Anthropic의 지속적인 상업적 성과에 달려 있음. 배치(Deployment)와 관련해, 당사자들은 특정 운영 및 재무 파트너들과 논의 중

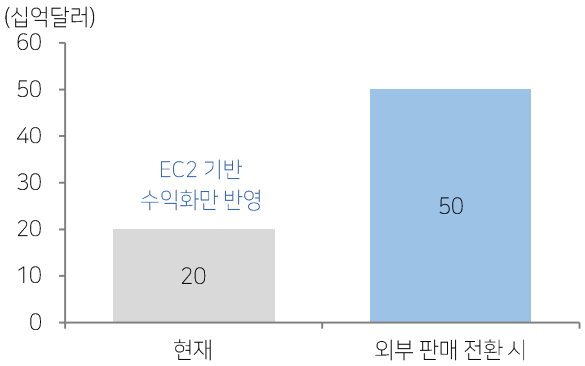
Source: Broadcom, 다올투자증권

Fig. 2: Anthropic 매출 Run-Rate 추이



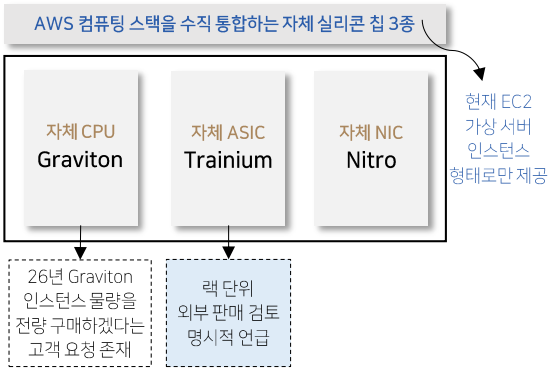
Source: Anthropic, Bloomberg, 다올투자증권

Fig. 3: AWS 칩 매출 Run-Rate 전망



Source: Amazon, 다올투자증권

Fig. 4: AWS 자체 칩 3종



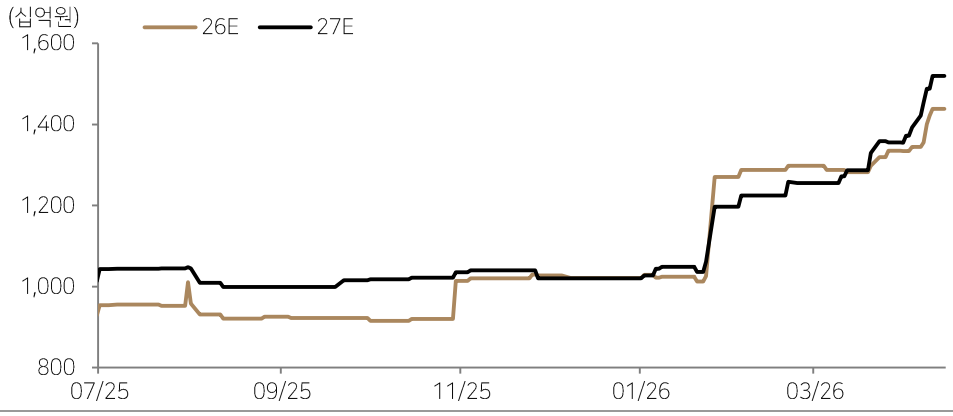
Source: Amazon, 다올투자증권

Fig. 5: FC-BGA 증설 History

주요 업체	시기	투자액	투자 계획	증설 내용	비고
해외 기업					
Ibiden	2018/11	1,300억엔 ($1.2B)	-	오가키 공장 증설	-
	2021/04	1,800억엔 ($1.7B)	FY21 하반기 ~ FY23	가마 공장 신설	-
	2021/09	미공개	FY22~FY25	오노 공장 신설	25년 10월 준공
	2026/02	5,000억엔 ($3.4B)	FY26~FY28	가마 공장, 오노 공장 라인 증설	1단계 2,200억엔
NanYa PCB	2021/05	80억 대만달러 ($0.3B)	1Q23 운영 개시 목표	수린 공장 FC-BGA 라인 증설	20년 대비 Capa +40% 확대
AT&S	2021/06	17억 유로 ($2B)	21년 하반기 ~ 24년 운영 개시	말레이시아 쿠림 신공장 착공	23년 이후 글로벌 Capa 70% 확대
Shinko	2021/10	1,400억엔 ($1.3B)	FY22 ~ FY25	나가노현 신규 공장 및 설비 확충	FC-BGA 캐파 ~50% 확대
Unimicron	2021/12	200억 대만달러 ($0.7B)	-	신주 공장 FC-BGA 라인 확장	-
국내 기업					
삼성전기	2013/01	1.3조원	-	베트남 생산법인 설립	-
	2021/12	1조원	-	베트남 공장 FC-BGA 생산라인 증설	-
	2022/02	3,000억원	-	베트남 공장 FC-BGA 생산라인 증설	-
	2022/06	3,000억원	-	부산·세종 FC-BGA 투자	-
	2026/04	1.8조원	-	베트남 공장 FC-BGA 생산라인 증설	28년 이후 양산
대덕전자	2020/07	900억원	-	시화 본사 신규 FC-BGA 생산라인 구축	고부가 FC-BGA 사업 진출
	2021/03	700억원	-	설비 증설 (2차)	기존 투자분 대비 +78% 캐파
	2021/12	1,100억원	-	설비 증설 (3차)	-
	2022/04	2,700억원	-	설비 증설 (4차)	연매출 4,000억 규모 추가 캐파
LG이노텍	2022/02	4,130억원	22~24년	FC-BGA 설비 및 생산라인 구축	-

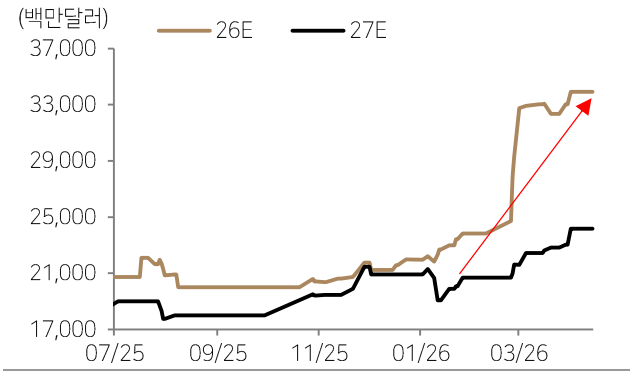
Source: 각 사, 언론종합, 다올투자증권

Fig. 6: 삼성전기 연간 CapEx 컨센서스 추이



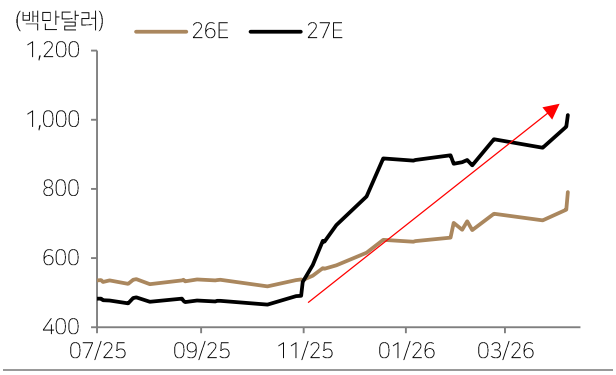
Source: QuantiWise, 다올투자증권

Fig. 7: 유니마이크론 연간 CapEx 컨센서스 추이



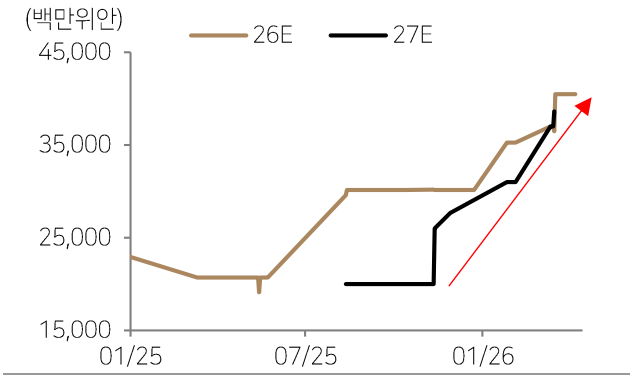
Source: Bloomberg, 다올투자증권

Fig. 8: 이비덴 연간 CapEx 컨센서스 추이



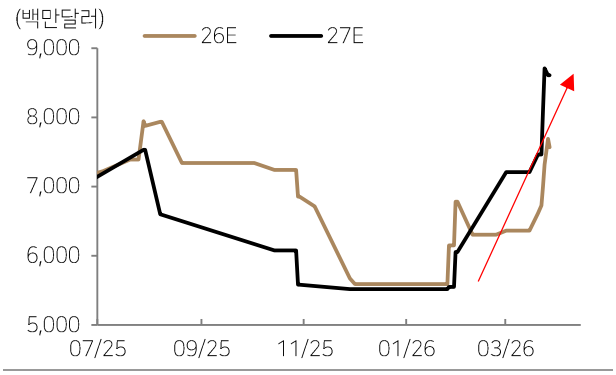
Source: Bloomberg, 다올투자증권

Fig. 9: Zhending 연간 CapEx 컨센서스 추이



Source: Bloomberg, 다올투자증권

Fig. 10: Kinsus 연간 CapEx 컨센서스 추이



Source: Bloomberg, 다올투자증권

Compliance Notice

당사는 본 자료를 기관투자가 등 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 당사는 본 자료 발간일 현재 해당 기업의 인수·합병의 주선 업무를 수행하고 있지 않습니다. 당사는 자료작성일 현재 본 자료에서 추천한 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 당사는 본 자료 발간일 현재 해당 기업의 계열사가 아닙니다. 당사는 동 종목에 대해 자료작성일 기준 유가증권 발행(DR, CB, IPO, 시장조성 등)과 관련하여 지난 12개월간 주간사로 참여하지 않았습니다. 당사는 상기 명시한 사항 외에 고지해야 하는 특별한 이해관계가 없습니다. 본 자료를 작성한 애널리스트 및 그 배우자는 발간일 현재 해당 기업의 주식 및 주식 관련 파생상품 등을 보유하고 있지 않습니다. 본 자료의 조사분석담당자는 어떠한 외부 압력이나 간섭 없이 본인의 의견을 정확하게 반영하여 작성하였습니다. 본 자료는 '나눔스퀘어'와 '아리따 글꼴'을 사용하여 작성하였습니다

투자등급 비율

BUY : 91.7%	HOLD : 8.3%	SELL : 0.0%

투자등급 관련사항

아래 종목투자의견은 향후 12개월간 추천기준일 종가대비 추천종목의 예상 기대수익률을 의미

- BUY: 추천기준일 종가대비 +15% 이상.
- HOLD: 추천기준일 종가대비 -15% 이상~ +15% 미만.
- SELL: 추천기준일 종가대비 -15% 미만.

투자 의견이 시장 상황에 따라 투자등급 기준과 일시적으로 다를 수 있음
동 조사분석자료에서 제시된 업종 투자의견은 시장 대비 업종의 초과수익률 수준에 근거한 것으로, 개별 종목에 대한 투자의견과 다를 수 있음

- Overweight: 해당 업종 수익률이 향후 12개월 동안 KOSPI 수익률을 상회할 것으로 예상하는 경우
- Neutral: 해당 업종 수익률이 향후 12개월 동안 KOSPI 수익률과 유사할 것으로 예상하는 경우
- Underweight: 해당 업종 수익률이 향후 12개월 동안 KOSPI 수익률을 하회할 것으로 예상 경우

주) 업종 수익률은 위험을 감안한 수치